DERWENT-ACC-NO:

1987-175509

DERWENT-WEEK:

198725

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Large wiring board for high power circuit - produced by

selecting <u>circuit</u> pattern, <u>jetting molten</u> copper particles through nozzle linked with robot arm etc.

NoAbstract Dwg 1/3

PATENT-ASSIGNEE: HITACHI LTD[HITA]

PRIORITY-DATA: 1985JP-0247076 (November 6, 1985), 1985JP-0247076 (November 6,

1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 62108595 A

May 19, 1987

N/A

004

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 62108595A

N/A

1985JP-0247076

November 6,

1985

INT-CL (IPC): H05K003/16

ABSTRACTED-PUB-NO:

EOUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: WIRE BOARD HIGH POWER CIRCUIT PRODUCE SELECT CIRCUIT PATTERN JET

MOLTEN COPPER PARTICLE THROUGH NOZZLE LINK ROBOT ARM NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: L03 V04

CPI-CODES: L03-H04E3;

EPI-CODES: V04-R02;

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 108595

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)5月19日

H 05 K 3/16

6736-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

図発明の名称 配線基板

到特 頤 昭60-247076

29出 願 昭60(1985)11月6日

藤井 禎 三 70発 明 者

勝田市市毛1070番地 株式会社日立製作所水戸工場内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 の出 願 人

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

発明の名称 配線基板

特許請求の範囲

1. 絶縁板の片面あるいは、両面に、導電性金属 を溶射し、指定の回路パターンが形成されてなる ことを特徴とする配線基板。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は、配線基板に係り、特に、大電流回路 が可能な、導体の幅、厚さの大きい配線基板に関 するものである.

(発明の背景)

從来の厚板利用による配線基板は、特開昭57-178398号に記載の様に、所要の配線パターンと、 これらを連結する如く形成した付加パターンとか らなる形状に打抜いた接着剤付導体板を基板に接 着し、しかる後に付加パターン部を基板とともに 穿孔により切断し、所要の配線パターンを得る方 式が提案されている。

この方法では、あらかじめパターン加工された

導体板を基板に接着するため、複雑形状で、剛性 のない導体板のハンドリング動作が必要となると ともに、不要の付加パターン部を接着後、削除す る工程が必要とするという欠点があつた。

(発明の目的)

本発明の目的は、配線基板に関して、特に、大 電流回路が可能な、導体幅、厚さの大きい配線基 板を提供することにある。

(発明の概要)

本発明は、絶縁板の片面あるいは、両面に導電 性金属を溶射することにより、指定のパターン回 路を形成させることにより配線基板とする方式と することにより、流す回路電流・電圧にあわせた **導体部制及び厚さが選択可能としたものである。**

(発明の実施例)

以下、本発明の実施例を第1~3図により説明 する。 絶級板2を固定するテーブル4と、制御盤 7により各軸が制御されるロボツト8、このロボ ツト8のハンド部9に溶射ノズル5が固定され、 格射制御装図6により溶射ノズル5の溶射条件が

本実施例によれば、溶射ノズル5の位置決めに ロボツト8を用いているため、絶縁板2の大きさや、回路パターンの変化にもフレキシブルに対応 できるという効果がある。

(発明の効果)

本発明によれば、導電性金属の溶射条件の選定により溶射金属幅及び厚さを自由に選択可能とな

るため、大電流を洗すことが出来る回路パターン が自在に製作できるという効果がある。

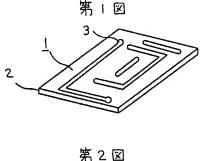
図面の簡単な説明

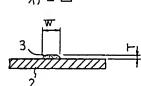
第1回は本発明の配線基板の実施例の斜視図、 第2回は第1回の導電性金属部分の断面図、第3 図は第1回の配線基板を製作する装置の全体斜視 図である。

1 … 配線基板、 2 … 絶縁板、 3 … 導電性金属、 5 … 溶射ノズル。

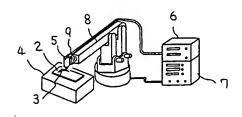


代理人 弁理士 小川勝男





第3図



--440--